

DUPONT™ TEMPRION™ GF0300

Einkomponentige, silikonfreie Gap-Filler Masse, dosierbar



DuPont™ Temprion™ GF0300 ist ein nicht silikonhaltiger, zähflüssiger Gap-Filler mit einer thixotropen Formulierung, die eine bequeme Aufbringung durch Dispensen ermöglicht. DuPont™ Temprion™ Gf0300 ist hoch-viskose und anfänglich klebrig. Dadurch ist die Handhabung erleichtert und es wird effizient eine Migration in unerwünschte Bereiche vermieden. Nach der Aufbringung härtet das Material langsam aus. Dadurch wird dauerhaft ein langsames Davonkriechen durch die Wärmezyklen vermieden.

Die silikon-freie Formulierung von DuPont™ Temprion™ GF0300 verhindert sehr effizient das Auspumpen, Ausgasen oder das Austreten von Silikonölen. Auf diese Weise kommt es nicht zu den gefürchteten Belägen auf optischen Oberflächen, Kontakten und Elektronik.

Technische Kenndaten von DuPont™ Temprion™ GF0300	
Wärmeleitwert:	3,5 W/m*K
Viskosität bei 25°C	300.000 mPas
Spezifisches Gewicht:	2,8 g/cm ³
Ausbluten nach 24h @ 200°C:	0,0
Ausgasungen nach 24h @ 200°C:	0,0
Durchbruchspannung:	12,5 kV/mm
Dielektrische Konstante:	5,0 (@ 1MHz)
Volumenwiderstand:	>2x10 ¹⁵ Ohm*cm
Brennbarkeit:	Nicht brennbar
RoHS Compliant:	Ja
Anwendungen	Wärmeleitmaterial für Kühlkörper, IGBT, CPU, Leistungselektronik, Höhendifferenzausgleich, Wärmeausdehnungsausgleich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.cmc.de

Tel: (0049) 6233/872-300 Fax: (0049) 6233/872-390 info@cmc.de